

くまもとから世界へ
半導体の
未来を切り拓く

令和6年
4月

工学部 半導体デバイス工学課程 創設

入学定員：20名



<https://www.eng.kumamoto-u.ac.jp/>

Feature

強み・特徴

半導体教育に特化したカリキュラム

Point 1

半導体工学の基礎学問を学修した上で、半導体デバイスプロセスや半導体システム設計、デバイス評価技術などの高度な専門性を高める

Point 2

授業は、最先端の半導体研究を行っている教授陣に加え、企業の第一線で活躍中の研究者／技術者や経営者が担当。インターンシップなど、企業との連携による実践的な科目が揃う

Point 3

社会的要請の強い半導体関連分野において、世界で活躍するための英語運用能力とコミュニケーション能力を高めるプログラムを用意

Faculty of Engineering

工学部 半導体デバイス工学課程の強み

教育の概要

半導体デバイスの設計・製造プロセス全体に対する俯瞰力に加えて、産業界の半導体人材育成ニーズを踏まえ、半導体研究開発に不可欠な、物理/化学/数学/材料/機械などの基礎学問(“工学リベラルアーツ”)の修得を重視したカリキュラムとする。さらに、地元半導体企業と連携して実務家教員を雇用し、OJT/PBL(現場型+課題解決型)教育を積極的に取り入れた教育プログラムを提供する

育成する人材

半導体デバイス製造の前工程から後工程に至る製造過程における基盤的専門知識を備え、半導体デバイスの製造・評価・開発に携われる人材へ

- ・大規模集積回路 (LSI) 回路設計・システム設計エンジニア
- ・半導体デバイスプロセスエンジニア など

入 試

1 年次入学 (定員 20 名)

特別選抜及び一般選抜の実施を検討中

入 試 日 程	入学者選抜要項公表	学生募集要項公表	大学入学共通テスト	試験日程	合格発表
一般選抜前期日程	令和5年7月 (予定)	令和5年11月 (予定)	令和6年1月 13日(土)、14日(日)	令和6年2月 (予定)	令和6年3月上旬 (予定)
学校推薦型選抜Ⅱ (大学入学共通テストを課す)				令和6年2月 (予定)	令和6年2月 (予定)

